

SMD-SCHABLONEN

Ansprechpartner
Dittmar Klein

SCHABLONENTYPEN

- SMD-Schablonen
- Prototypenschablonen
- Klebeschablonen
- Wafer bumping Schablonen
- Viafill Schablonen für LTCC-Anwendungen
- Stufenschablone (auf Anfrage)

LAYOUTGESTALTUNG

- Aperturvergrößerung und -verkleinerung
- Aperturformänderung,
z.B. Homeplates, Abrunden der Ecken
- Spiegeln / Drehen des Gesamtlayouts oder von Teilbereichen
- Mehrfachnutzenerstellung
- Vermessen von Leiterplatten
- Herstellung einer Schablone aus beigestellter Leiterplatte / Schablone

DATENFORMATE

- Gerber, Ext. Gerber, DXF, DWG
- Freigabe-/ Prüfdaten in Ext. Gerber

SCHABLONENMATERIAL

- V2A (1.4301)
- übliche Materialstärken:
50, 75, 100, 120, 150, 180, 200, 250 μm
- spez. Materialstärke von 20 bis 800 μm
- max. Schablonengröße 1000 x 1000 mm
- Blechdickentoleranz: \pm 3%
- Härte Hv: min. 370
- Zugfestigkeit (N/mm^2): $>$ 1100

LASERSCHNEIDTOLERANZEN

- Toleranz der Padgrößen: \pm 5 μm
- Positionstoleranz über Gesamtgröße: \pm 10 μm
- Reproduzierbarkeit: \pm 5 μm
- kleinste realisierbare Struktur: 50 μm
- kleinster Schnittspalt: 35 μm
- Zugfestigkeit (N/mm^2): $>$ 1100

QUALITÄTSSICHERUNG (ISO 9001:2008)

- Konturprüfung mittels 3D-Koordinatenmessmaschine
- optische Begutachtung der Schnittkanten
- Prüfprotokoll (auf Anfrage)

SCHABLONENBESCHRIFTUNG

- Klartext
- Barcode
- DataMatrix-Code

NACHBEARBEITUNG

- Finishbearbeitung durch Oberflächenbürsten in allen vier Richtungen
- elektro-chemische Nachbehandlung
- gefalzte Kante als Kantenschutz

KANTENPERFORATION FÜR FOLGENDE SCHNELLSPANNSYSTEME

- Micro Mount
- Quattroflex
- ZelFlex
- VectorGuard
- VectorMount
- Essemtec